

RMA258-15R 焊膏

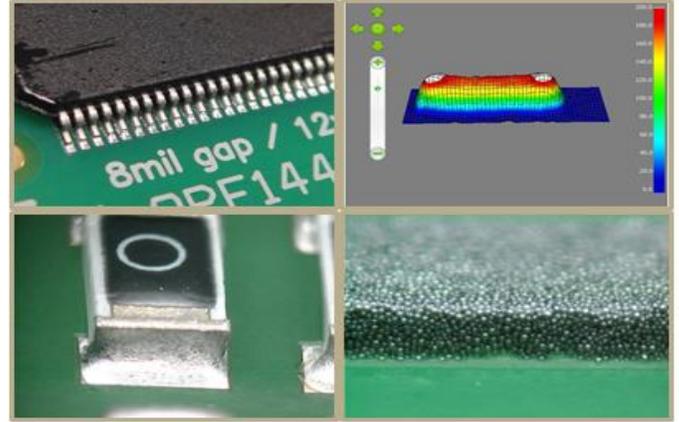
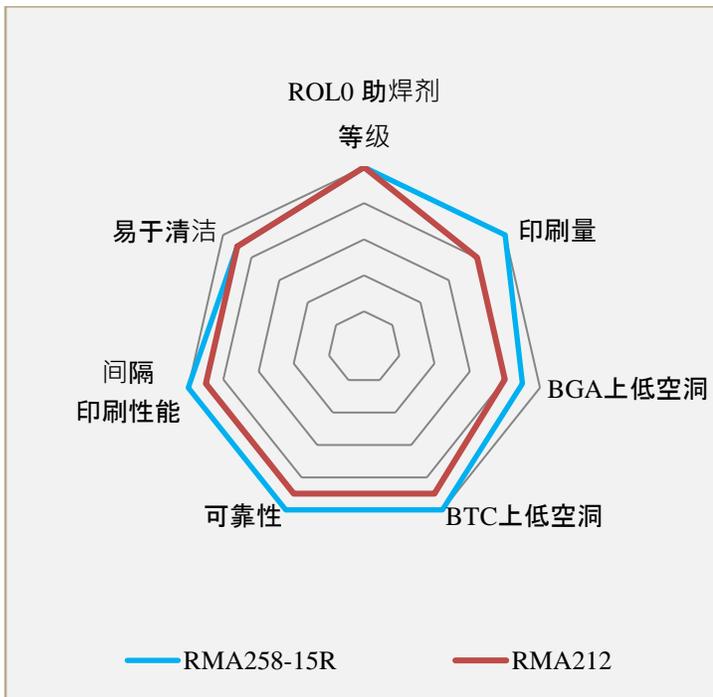
特性

- ▶ 优良的长时间印刷能力
- ▶ 润湿性强，对于无引脚的元件也能很好润湿
- ▶ 加强细间距印刷质量
- ▶ 在长时间高温中回流卓越
- ▶ 通过 IPC J-STD-004 测试，测试结果为 ROL0
- ▶ 减少空洞缺陷

描述

RMA258-15R 是一款松香基焊膏，专为高可靠性及军工电子产品设计。RMA258-15R 具有优良的长时间印刷能力，以及极小器件印刷。RMA258-15R 可降低 BGA/BTC 的空洞及窝枕缺陷，极佳的活化性能使焊点表面光滑闪亮。RMA258-15R 在长时间，高温回流效果卓越，常用于高集体组件和电源管理。RMA258-15R 残留可被蒸汽清洗系统，醇类和皂化清洗系统清除。

特点



处理以及储存

合金	参数	时间	温度
无铅	冷藏密封保质期	1 年	0°C-12°C (32°F-55°F)
无铅	非冷藏密封保质期	6 个月	< 25°C (< 77°F)
有铅	冷藏密封保质期	9 个月	0°C-12°C (32°F-55°F)
有铅	非冷藏密封保质期	4 个月	< 25°C (< 77°F)

请勿将使用过的焊膏添加到未使用过的锡膏中。使用过的锡膏要与未使用过的锡膏分开储存；对未使用的锡膏，要将内盖或顶盖盖好并重新密封。开封后锡膏的保质期取决于环境和应用，详情请见 AIM 焊膏使用指导。合金的成分和贮存条件可能会影响保质期。请参阅 RMA258-15R 分析证书中的特定信息

清洁

回流焊前：使用 AIM DJAW-10 有效地从钢板上将 RMA258-15R 焊膏清除。DJAW-10 可使用钢板擦拭手动使用。DJAW-10 不会使 RMA258-15R 焊膏干燥且可加强传输性能。请勿过量使用 DJAW-10。不要把 DJAW-10 涂于钢网顶部，不推荐在工艺过程中使用异丙醇（IPA），但可用于最后钢网清洗。

回流后残留：RMA258-15R 残留物无需清洗。在必须清洁的情况下，AIM 已与其工业合作伙伴确保 RMA258-15R 残留物可使用普通除焊剂清洁。联系 AIM 以获得清洁兼容性信息。

回流曲线

欲获得详细回流曲线信息，请登录 <http://www.aimsolder.com/reflow-profile-supplements>。可联系 AIM 获得更多信息。

印刷

以下推荐的印刷机初始设定取决于 PCB 和 PAD 设计	
参数	推荐初始设定
刮刀压力	0.9 - 1.5 磅/英寸每刀片
刮刀速度	0.5 - 6 英寸/秒
接触距离	接触 0.00mm (0.00' ')
PCB 分离距离	0.75 - 2.0mm (.038 - .080' ')
PCB 分离速度	3.0 - 20.00 mm/秒

测试数据小结

名称	测试方法	结果	
IPC 助焊剂分类	J-STD-004	ROLO	
名称	测试方法	典型结果	图像
铜镜	J-STD-004 3.4.1.1 IPC-TM-650 2.3.32	低	
腐蚀性	J-STD-004 3.4.1.2 IPC-TM-650 2.6.15	通过	
定量卤化物， 铬酸银测试	J-STD-004 3.5.1.1 IPC-TM-650 2.3.33	通过	
定量卤化物、 氟化点	J-STD-004 3.5.1.2 IPC-TM-650 2.3.35.1	无氟化物	
表面绝缘电阻	J-STD-004A 3.4.1.4 IPC-TM-650 2.6.3.3	通过	
助焊剂固体含量， 非挥发性测定	J-STD-004 3.4.2.1 IPC-TM-650 2.3.34	95.7% 典型值	
酸值测定	J-STD-004B 3.4.2.2 IPC-TM-650 2.3.13	133 mg KOH/ g flux 典型值	

名称	测试方法	典型结果	图像
助焊剂比重测定	J-STD-004 3.4.2.3 ASTM D-1298	3.68 典型值	
粘度	J-STD-005A 3.5.1 IPC-TM-650 2.4.34	可提供印刷、 点涂版本	
外观	J-STD-004 3.4.2.5	灰色，光滑的 油脂状	
坍塌测试	J-STD-005A 3.6 IPC-TM-650 2.4.35	通过	
锡球测试	J-STD-005A 3.7 IPC-TM-650 2.4.43	通过	
粘性	J-STD-005A 3.8 IPC-TM-650 2.4.44	48.8 g 典型值	
润湿性	J-STD-005A 3.9 IPC-TM-650 2.4.45	通过	